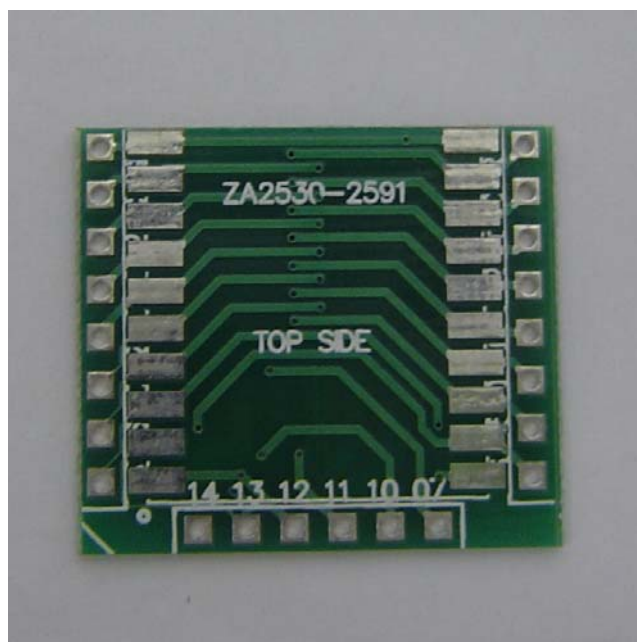


## ZA2530A/ZA2530-2591

### DIP 转接底板焊接调试说明

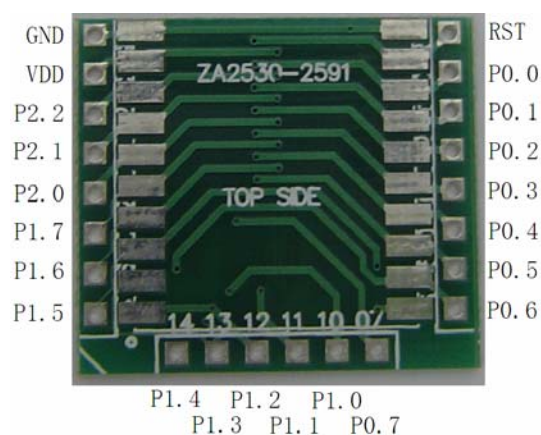
为方便调试，本公司的 2.4G ZigBee 射频模块附带 DIP 转接板，方便将模块转接为 DIP 引脚便于调试。



#### 引脚定义

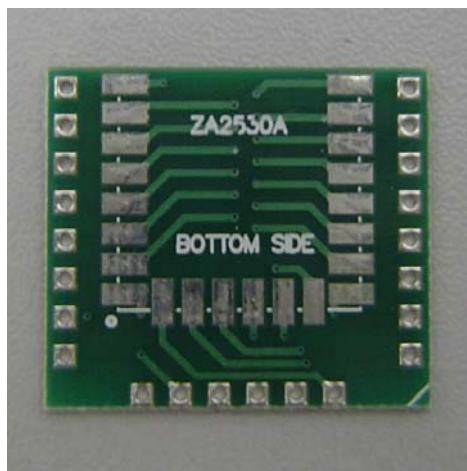
一般情况，应保证转接板标有 TOP SIDE 的一面面向上，DIP 排阵位于转接板下标平面。如此可确保焊接的转接模块可以应用于本公司大部分相关调试工具与底板。

TOP SIDE 向上时 DIP 侧引脚定义如下图所示



## ZA2530A 焊接

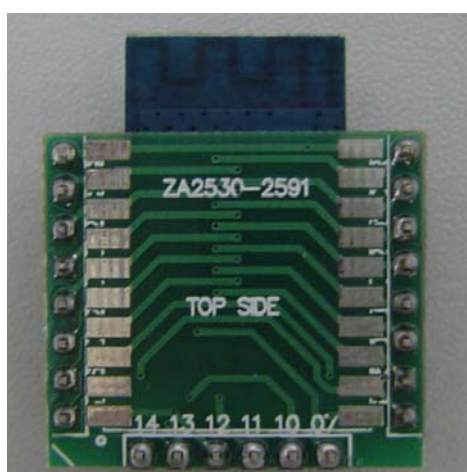
首先将转接板翻面，BOTTOM SIDE 向上



将 ZA2530A 焊接在该面，焊接过程请注意本手册结尾的《焊接注意事项》



将转接板翻回正面 TOP SIDE 向上，并在底部焊接排针。

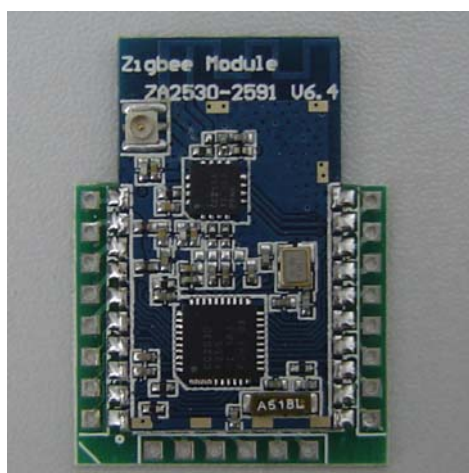


焊接完毕如下图所示。



### **ZA2530-2591 焊接**

直接将 ZA2530-2591 焊接于转接板正面，焊接过程请注意本手册结尾的《焊接注意事项》



在底部焊接排针。

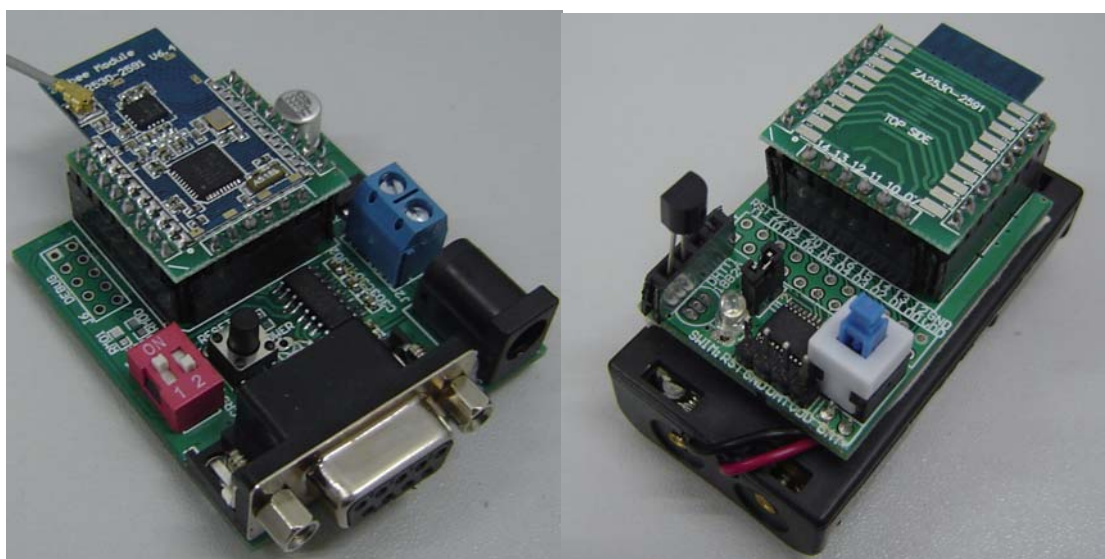


焊接完毕如下图所示。



## 连接使用

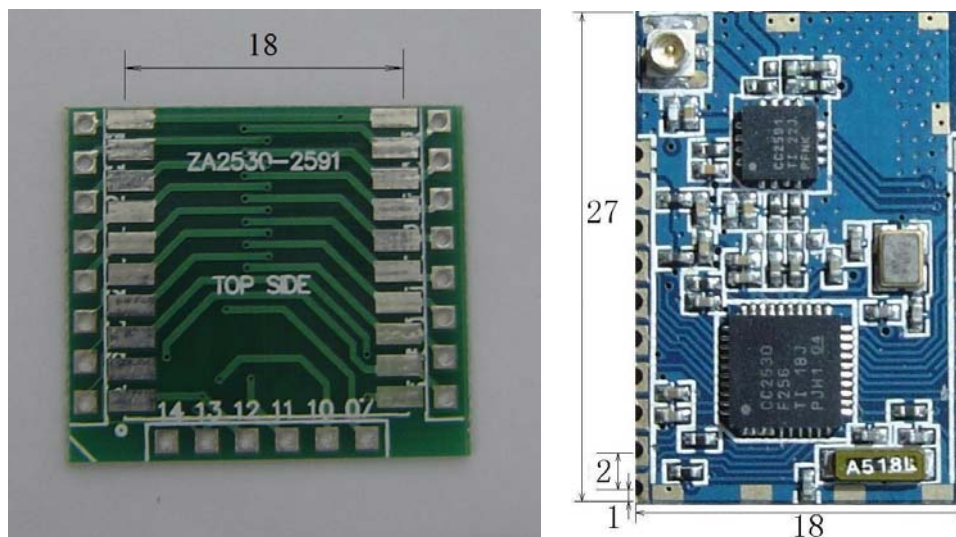
完成焊接的模块可方便应用于相应调试工具，例如下图所示温度采集方案的主机和可休眠终端。





## 焊接注意事项

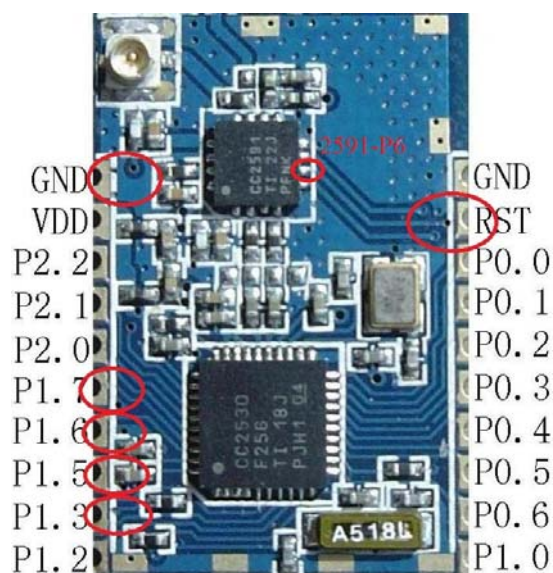
焊盘引脚与所焊模块如下图所示。



为便于批量焊接快速简便，转接板与元件库的焊盘做得较长，如上图尺寸标注，焊接完毕后焊盘约有 1/2 露于模块外侧，约有 1/2 位于模块底。

在很少情况下，如焊接时模块与底板焊盘间留有过的间隙，或焊接温度很高，可能导致焊锡流入模块与焊盘之间的间隙以致焊盘与板内某些过孔发生短路。

有可能发生焊盘与周边过孔短路的位置如下图所示



也就是 RST 与 2591 第 6 脚，GND 与 VDD，P1.7 与 GND，P1.6 与 GND，P1.5 与 GND，P1.3 与 2591 第 6 脚之间有可能出现类似问题。

事实上，目前仅发现 RST、P1.3 由于焊接不慎导致与 2591 第 6 脚的过孔发生短路的情况，其它情况由于焊盘与过孔距离较远未见发生过问题。

如要检测此类焊接问题，可用万用表量图中所示 RST、P1.3 焊盘与 2591 第 6 脚是否发生短路即可。

此情况发生概率极小，一般是无经验的焊接温度过高且焊盘间留有空隙才会导致。为完全避免此类问题，我们也提供底板焊盘较短的元件库。但是由于焊盘过短，焊接时需要刻意对准，可能会影响焊接效率。选用何种元件库请自行权衡。